

ChargeStackコネクタ

今日のコンパクトで高性能なデバイスの需要を満たすには、最小限のスペースで電力と信頼性の両方を提供するコネクタが必要です。超薄型かつコンパクトな設計で最大20.0Aを処理する性能を備えた基板対基板ChargeStackコネクタは、電源コンタクトとシグナルコンタクトを単一のフットプリント内に統合してPCBのスペース効率を最大化します。

利点と特徴

PCB上のスペースをさらに節約

コネクタの小型化された基板対基板設計によってコネクタの高さとサイズが低減され、PCB上の貴重なスペースを節約できます。そのため、アセンブリーをさらに薄型化するとともに、より多くの半導体とチップをPCBに取り付けることが可能になります。

高速充電要件をサポート

コネクタは、専用端子を使用して10.0Aと20.0Aを個別にサポートすることで温度の上昇を最小限に抑え、電力損失を低減するため、最適な電気性能が確保されます。

ハウジングの破損や損傷に起因する故障率を低減

コネクタには、フルメタルアーマーと、ハウジングを保護して機械的堅牢性を強化する完全なオーバーモールド構造が備わっています。

電流	0.3A (ピンあたり)、10.0~20.0A (電源ピンとネイル)
回路数	6 (シグナル) および4 (電源)
嵌合対象	228351 (プラグ) / 228350 (リセプタクル) 229326 (プラグ) / 229325 (リセプタクル) 216657 (プラグ) / 216656 (リセプタクル) 220251 (プラグ) / 220250 (リセプタクル)
絶縁抵抗	100メガオーム
高さ	0.52mm (10.0/20.0A) / 0.70mm (15.0/18.0A)
動作温度	-40~+80°C

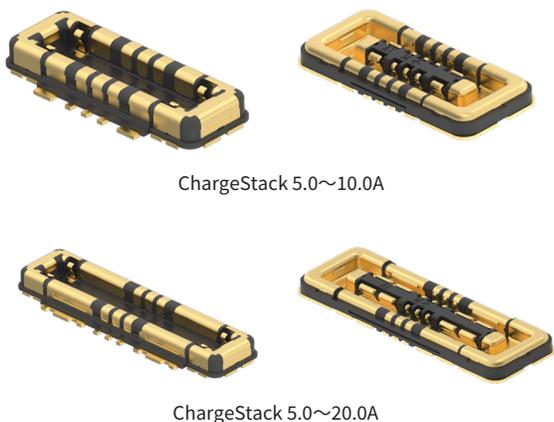
安定した適切な嵌合状態を実現

コネクタのデュアルコンタクト設計と十分なワイブ長は、過酷な環境ストレスに対する耐性を高めるとともに、コンタクト表面を効果的にクリーンな状態にすることで信頼性に優れた電気的接触を維持します。

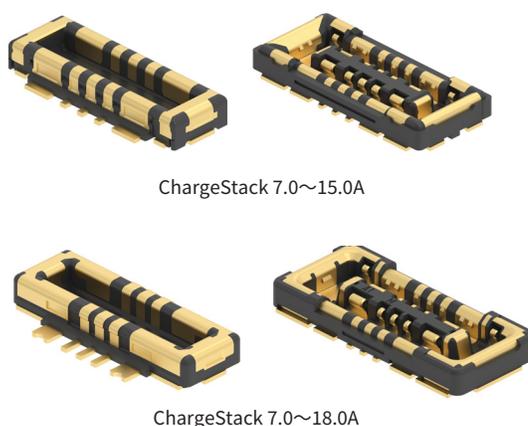
効率とデバイス安全性を向上

LLCRが低いコネクタによる高電力供給は、発熱と電力損失を低減し、効率的なエネルギー伝達とコネクタの寿命延長を実現します。

嵌合高さ - 0.52mm



嵌合高さ - 0.70mm



ChargeStackコネクタ

市場と用途

医療技術

患者モニタリングデバイス
手術器具と手術システム
治療器具

モバイルデバイス

ノートパソコン
PC
スマートフォン
タブレット

ネットワーク

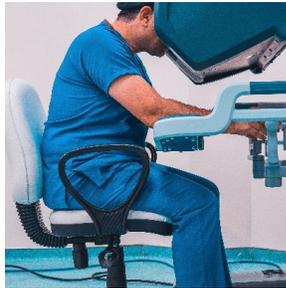
ゲートウェイ
ハブ
モデム
ルーター

電気通信

Bluetoothデバイス
GPSデバイス
テレビ信号
無線デバイス

ウェアラブル

AR/VRメガネ
イヤホン
スマートウォッチ



手術器具と手術システム



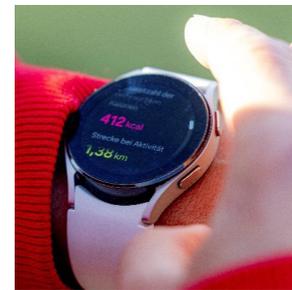
ノートパソコン



モデム



テレビ信号



スマートウォッチ

仕様

参考情報

梱包：エンボステープとリール
設計仕様：ミリメートル
RoHS：はい
ハロゲンフリー：低ハロゲン

電氣的仕様

電圧（最大）：50V
電流（最大）：
シリーズ228350/22835 -
シグナルコンタクト：0.3A（1回路あたり）
電源コンタクトとネイル：10.0Aシリーズ
229325/229326 -
シグナルコンタクト：0.3A（1回路あたり）
電源コンタクトとネイル：20.0A
接触抵抗（最大） -
シグナルコンタクト：30ミリオーム
電源コンタクト：5ミリオーム
絶縁抵抗（最小）：100メガオーム
絶縁耐電圧：250V AC

機械的仕様

挿入力（最大）：
初回：40N
30サイクル以降：40N
引抜き力（最小）：
初回：8N
30サイクル以降：4N

物理的仕様

ハウジング：LCP、UL 94V-0、黒色
コンタクト：銅合金
メッキ：
コンタクト面 - 金
はんだテール面 - 金
下地メッキ - ニッケル
動作温度：-40~+80°C

www.molex.com/ja-jp